

## テクニカルデータシート

### DOWSIL™ SC 4471 CV Thermally Conductive Compound

1液、白色、非硬化・流動性、熱伝導性コンパウンド、低分子シロキサン低減品

#### 特徴と長所

- 1液
- 非硬化
- 流動性
- 良好な熱伝導性 – 電子部品から熱を逃がす
- 低オイルブリード
- 低分子シロキサン低減品

#### 組成

- シロキサン・ポリマー・マトリックス
- 熱伝導性フィラー

#### 用途

- DOWSIL™ SC 4471 CV は、車載 ECU やインバーター装置などの電子機器の冷却のために、効率的な熱伝導性を持つように設計されています。

#### 代表特性

出荷規格ではありません。

試験項目	単位	測定値
色		白色
粘度	cP	116,000
	mPa-sec	116,000
	Pa-sec	116
密度	g/cm <sup>3</sup>	2.76
揮発分 (105°C, 24 時間)	Wt%	0.11
	Wt%	0.02
熱伝導率	W/mK	2
体積抵抗率	Ω-cm	2E+15

UNRESTRICTED- May be shared with anyone

©TM: ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーまたはその関連会社の商標

DOW TORAY の商標の TORAY の部分は、使用許諾のもとで使用している Toray Industries, Inc. の商標

DOWSIL™ SC 4471 CV Thermally Conductive Compound

© 2019 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

## 製品概要

ダウの熱伝導性コンパウンドはグリース状シリコン材料で、熱伝導性フィラーが高充填されています。この組成により、高い熱伝導性、低ブリードなどを実現しています。この様なコンパウンドはヒートシンクの確実な密着を維持し、電気・電子機器からヒートシンクまたは筐体への放熱性を向上させることで、電子機器の全体的な効率を高めます。電子機器は常に高い性能を発揮できるように設計されています。特に家庭用電化製品の分野では、絶えずより小型でコンパクトな設計が求められるという傾向があります。このような要因により、一般的には電子機器から発生する熱が増加しています。電子機器の熱の管理は設計技術者にとって大きな課題です。

電子機器の温度を低く保てば、電子機器の耐用期間中、効率的な動作と高い信頼性を確保できます。従って、熱伝導性を持つ材料が重要な役割を果たします。熱伝導性材料は、熱媒体（ヒートシンク）を介して熱源（デバイス）から周囲に熱を逃がします。このような材料は低い熱抵抗、高い熱伝導性などの物性を持ち、薄い膜厚（BLT: Bond Line Thicknesses）を実現できるため、電子機器から効率的に熱を逃がすことができます。

## 溶剤暴露

一般に、この製品は最小限または断続的に溶剤にさらされる場合は耐性を持ちますが、溶剤にさらすことを避けるのが最善です。

## 保証期間

製品は元のパッケージで保管し、汚染防止のためにしっかりと封またはカバーをするようお願いいたします。製品ラベルに記載してある特別な注意に従って保管してください。ラベルに記載された製品の使用期限までにご使用ください。

## 使用上の注意

使用に際し必要な安全情報は本データシートには記載されていません。ご使用の前に、安全データシート(SDS)及び、パッケージ又はパッケージのラベルに表示されている注意書きをよく読んで、使用上の安全をはかって下さい。安全データシート(SDS)はウェブサイト、[ja.consumer.dow.com](http://ja.consumer.dow.com) にアクセスしてお求めいただけます。さらに、代理店または担当営業にご依頼いただいても 結構です。

## 医療・医薬品用途への制限

本製品は、（ヘルスケア用途製品を除き、）一般工業用途向けに開発・製造されたものです。弊社製品は、医療または医薬用途向けに適合するものとして、試験されておられません。また、そのように表明されるものでもありません。

## 健康および環境に関する情報

弊社は、お客様の製品安全の必要性をサポートするために、広範囲におよぶプロダクト・スチュワードシップの組織やチームおよび各地域にて対応可能な製品安全並びに法令遵守のスペシャリストを有しております。

さらなる詳細な情報については、弊社のウェブサイト [ja.consumer.dow.com](http://ja.consumer.dow.com)、または弊社の担当営業までご連絡下さい。

UNRESTRICTED- May be shared with anyone

©TM: ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーまたはその関連会社の商標

DOW TORAY の商標の TORAY の部分は、使用許諾のもとで使用している Toray Industries, Inc. の商標

DOWSIL™ SC 4471 CV Thermally Conductive Compound

© 2019 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

## How Can We Help You Today?

弊社は、シリコン材料・アプリケーション・プロセスに関する豊富な知識をもとに、お客様が求める性能、デザインや製造上の課題解決に貢献しています。

弊社の製品と特性については [ja.consumer.dow.com](http://ja.consumer.dow.com) をご覧ください。

ダウは、世界中にカスタマーサービス、研究開発拠点、アプリケーションサポートチーム、営業所と工場を有し、あらゆる国や地域のお客様のニーズに応えています。

[ja.consumer.dow.com](http://ja.consumer.dow.com)

### 限定保証について一よくお読みください

ここに掲載する情報(以下「本情報」という)は、弊社が誠意をもって提供するものであり、正確であると確信するものです。但し、弊社製品についての使用条件や使用方法是、弊社のコントロールの及ばぬところでございますので、本情報を弊社製品が、お客様の意図する最終用途において、安全で、有効で、十分に満足するものであることを保証するためのお客様における試験の代わりとしては、使用しないで下さい。ここでご紹介する使用方法、用途などは、いかなる特許をも侵害していないことを保証するものではありません。

弊社は、弊社製品が出荷の時点で有効な販売規格に適合していることを保証致します。この保証に違反した場合、お客様の救済方法は、当該製品の購入代金の返金または当該製品の交換により対応いたします。

適用法により許容される最大限の範囲において、弊社は特に、製品の特定目的への適合性または商品適格性について、明示または黙示の保証をするものではありません。

また、弊社は、いかなる付随的または派生的な損害について何ら責任を負いません。



A DOW and TORAY Joint Venture